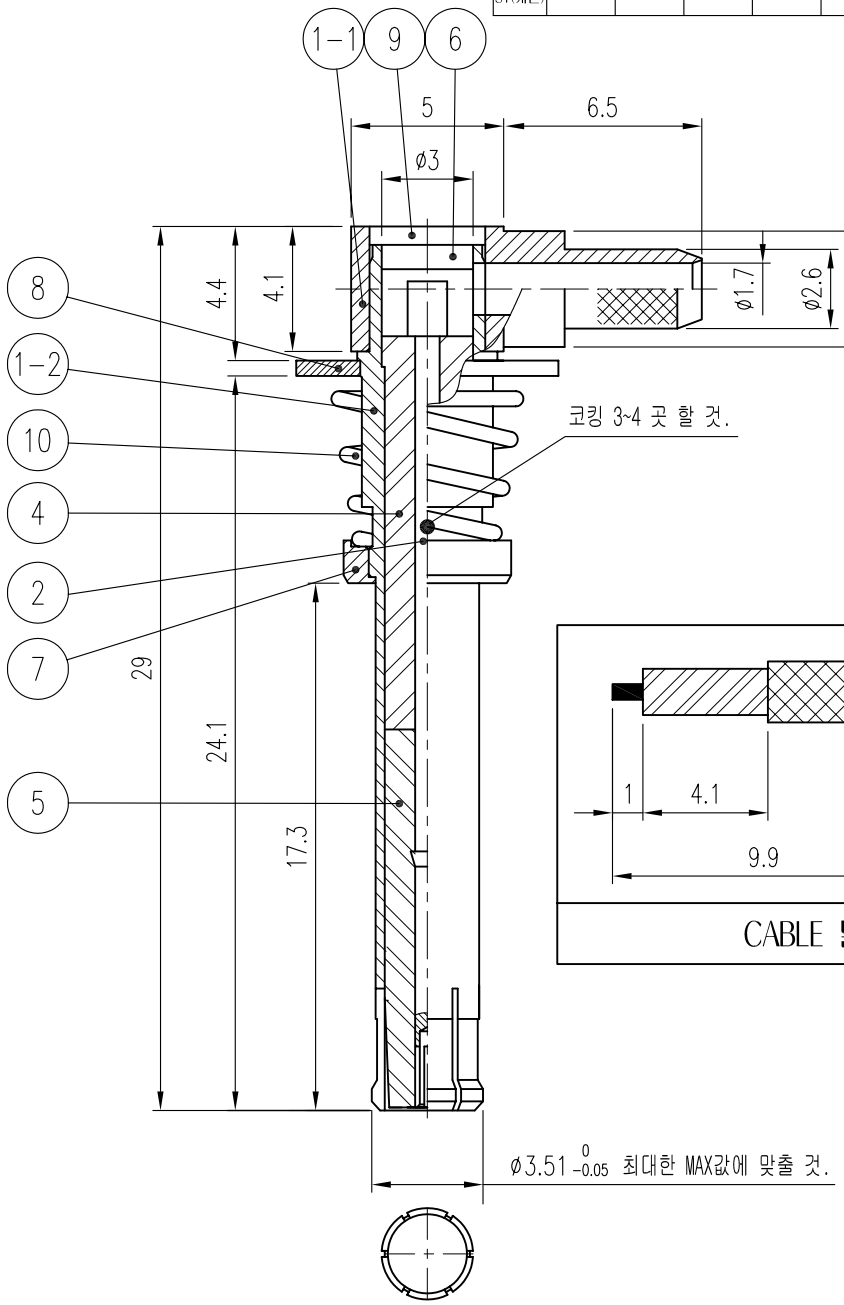
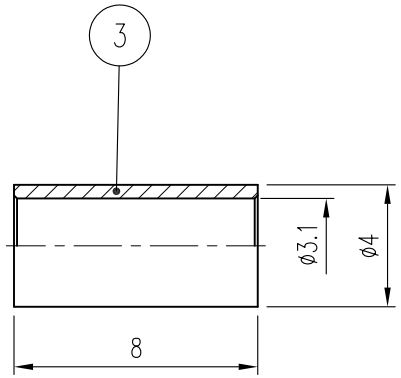
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

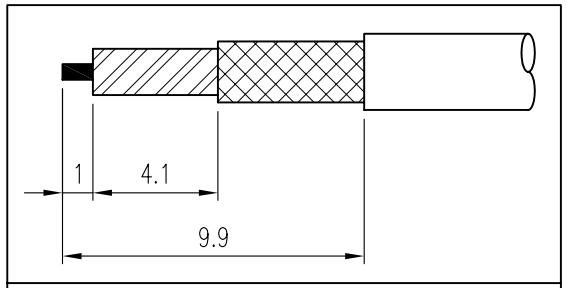
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





조립 순서

1. BODY에 4번 INSULATOR를 조립한다.
2. 2번 CONTACT를 조립한다.
3. BODY의 내경(ø3)을 지지하고 5번 INSULATOR를 BODY의 JACK 앞쪽에서 밀어 넣어 조립한다.
4. 케이블 탈피를 참조하여 케이블을 조립한다.
5. 케이블 심선과 PIN의 교차부를 땜한 후 6번 INSULATOR를 삽입 후 9번 COVER를 억지끼움한다.
6. 8번, 10번, 7번 부품은 케이블 도면을 참조하여 케이블 조립 후 사출몰딩 제품에 조립한다.



CABLE 탈피도

품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
10		SPRING	1	SUS		DSR00035-5/1 (RQ001)	
9		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCO00010-5/1 (LQ004)	
8		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00073-5/1 (LQ002)	
7		COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00003-5/1 (LQ006)	
6		INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN00938-N/1 (HQ002)	
5		INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN01232-N/1	
4		INSULATOR	1	TEFLON(White)		DIN01231-N/1	
3		FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00030-5/1 (F6413)	
2		CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01449-5/1	
1	1-2	BODY	1	BeCu	Gold Plate	DBB00130-5/1	DBD01876-4/1
	1-1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate		DBD01270-3/1 (DQ005A)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2008. 3. 21.		
승인			
검도			
제도			
작성부서	연 구 소		
척도 4/1	단위 mm	중량 —	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 스위치용 R/A RG-316

A4

도번 CN01654-7/1